

第3回 有機/無機接合研究委員会 公開シンポジウム

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。下記の通り、第3回有機/無機接合研究委員会を公開シンポジウムとして開催いたします。

有機/無機接合研究委員会では、電子デバイス実装分野における樹脂材料を中心とする「接着界面現象・接着機構の明確化、信頼性評価方法」に関する有機/無機接合界面科学およびヘテロジニアス界面科学の構築を目的に学術的な議論を行っており、産官学で情報交換できる場を提供しています。

本シンポジウムでは、近年注目される金属とプラスチックの直接接合や新しい接合界面の解析手法、さらには実部品への適用事例など、最新の技術動向をトピックスとして集めております。公開シンポジウムにすることで、より広範の研究者・技術者の方と情報交換することができ、本分野のさらなる発展が期待できます。皆様のご参加をお待ち申し上げます。

主催（一社）スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会

共催：（一社）エレクトロニクス実装学会電子部品・実装技術委員会（依頼中）

後援：（国研）産業技術総合研究所フレキシブルエレクトロニクス研究センター（依頼中）

開催日時： 平成31年3月13日（水）13:00～16:50

開催場所： 拓殖大学 文京キャンパス（予定）
〒112-8585 東京都文京区小日向3-4-14

定員： 先着 100名 [申込み締切り：平成31年2月27日（水）]

参加費： 10,000円（主催共催後援団体会員、JIEP全国大会参加者および学生、資料代含む）
15,000円（非会員、資料代含む）

申込方法： 以下のエレクトロニクス生産科学部会ホームページの申込みフォームよりお申込み下さい。
<http://sps-mste.jp/committee/>
※お支払いは、受付完了メールに記載された振込先まで銀行振り込みにてお願いいたします。

プログラム

| | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 13:00～14:10 | 『マルチマテリアルに向けた異種材料接合技術及び国際標準化動向』（35分） | 板橋 雅巳（大成プラス(株)） |
| | 『異材接合体強度と破壊様式に及ぼす界面端形状の影響（仮）』（35分） | 立野 昌義、徳元 黎一、村岡 俊輔（工学院大学） |
| 14:10～14:20 | 休 憩 | |
| 14:20～15:30 | 『隆起微細構造を用いた金属－プラスチック直接接合の可能性』（35分） | 前田 知宏（輝創(株)） |
| | 『有機/無機接合界面の分析手法』（35分） | 泉 由貴子（(株)東レリサーチセンター） |
| 15:30～15:40 | 休 憩 | |
| 15:40～16:50 | 『転写印刷を利用した極薄 MEMS のフィルム実装』（35分） | 竹井 裕介（産業技術総合研究所） |
| | 『導電性接着剤における有機/金属異相界面層の発達と導電性発現』（35分） | 井上 雅博、根岸 智仁、中澤 史穂（群馬大学） |